
IPC ERFA-møde, torsdag den 24. november 2022

Afholdes hos HYTEK

Dagsorden:

- 10:00** **Velkomst** v/Jens Taudal Andersen, HYTEK
- 10:05** **SPC / Six Sigma** v/ Søren Both, Grundfos
- Proceskapabilitet og SPC med hovedfokus på SPC, lidt baggrund og praktisk brug af værktøjerne med fokus på hvordan det bruges eller kan bruges i en elektronikproduktion.
- 11:05** **Pause**
- 11:15** **MacDermid Alpha Electronics Solutions, solderable finishes used for Printed Circuit Boards** v/ Hans Vrijhof, MacDermid Alpha Electronics Solutions
- An overview of different solderable finishes used for Printed Circuit Boards
 - OSP (Entek Plus HT)
 - Immersion Tin
 - Immersion Silver
 - ENIG and ENEPIG
 - More background on how these finishes are applied, difference between immersion and electroless plating, pros and cons of each finish
- 12:30** **Frokost**
- 13:30** **UL med fokus på UL-godkendelser i elektronikindustrien** v/ Jette Adamsen, UL/Demko
- UL 508A (Forskelle mellem USA og Europa)
- 14:30** **Nyt fra IPC** v/ Jens Taudal Andersen, HYTEK
- Gennemgang af de nyeste udgivne IPC-standarder mv.
- 14:45** **Eventuelt / afslutning**
- Forslag til emner på kommende møder